



Rapperswiler Klebstoff- Forum 2024

Dienstag, 25. Juni 2024, OST – Ostschweizer Fachhochschule, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona

Einladung zum Rapperswiler Klebstoff-Forum

Innovationen aus der Klebtechnik

Liebe Kolleginnen und Kollegen


Das Rapperswiler Klebstoff-Forum 2024 findet am Dienstag, 25. Juni 2024 auf dem Campus der OST – Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil-Jona statt.

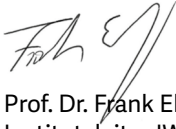
Das Forum mit dem Schwerpunkt Klebtechnik konzentriert sich auf Innovationen für industrielle Anwendungen und Produktentwicklungen. Diese Tagung bringt Ingenieur/innen, Forscher/innen und Expert/innen aus Industrie, Fachhochschulen und Universitäten zusammen, um den aktuellen Stand der Technik und die neuesten Entwicklungen in der Klebtechnik zu diskutieren.

Das Forum wird in deutscher Sprache abgehalten und bietet eine exzellente Gelegenheit, sich mit Kolleg/innen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser spannenden Veranstaltung zu sein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website: ost.ch/iwk/klebstoff-forum




Prof. Dr. Pierre Jousset
Fachbereichsleiter
Verbindungstechnik IWK


Prof. Dr. Frank Ehrig
Institutsleiter IWK

Programm

08.45 Uhr	Willkommens-Kaffee und Registrierung	13.50 Uhr	Klebertechnologie für Prozessverbesserungen bei der Montage von Kühlplatten Johannes Haberl , Autoneum Management AG
09.15 Uhr	Begrüßung Prof. Alex Simeon , Leiter Rektoratsstab OST	14.15 Uhr	Optimale Verstärkung von Metallprofilen mit Konstruktionsklebstoffen für industrielle Anwendungen Ulli Müller , Sika AG
09.20 Uhr	Das IWK – Ihr Partner für F&E in der Verbindungstechnik Prof. Dr. Pierre Jousset , Fachbereichsleiter Verbindungstechnik, IWK	14.45 Uhr	Kaffeepause
09.35 Uhr	Neue Klebstoffe und numerische Auslegungsmethoden für die Entwicklung der nächsten Generation Sandwichstrukturen für Bus- und Schienenfahrzeuge Michael Karcher / Siegmund von Manitus , Kisling AG/3A Mobility	15.10 Uhr	Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft in der Klebertechnologie: Debonding on Demand mit TEP Partikel Philipp Capol , Bodo Möller Chemie Schweiz AG
10.15 Uhr	Kaffeepause	15.35 Uhr	Ressourceneffiziente Holz-Stahl-Hybridbauweisen durch den Einsatz der Klebtechnik Matthias Albiez , KIT - Karlsruhe
10.40 Uhr	Aus dem Aerosense Projekt: Auslegung eines selbstklebenden und abnehmbaren Gehäuses für Messungen an Windkraftanlagen Julien Deparday , Fachbereich Windenergy Innovation, IET	16.05 Uhr	Bustransfer in den Techpark
11.05 Uhr	Verkleben einer sensitiven Therapiematte Joris van het Reve , Dividat AG	16.25 Uhr	Führungen durch den Techpark
11.30 Uhr	Mittagspause	17.00 Uhr	Apéro und Networking
13.25 Uhr	Entwicklung einer neuen Generation von modularen Dämpfeinzugssystemen mit integrierten Funktionalitäten Nejib Yezza , Hawa Sliding Solutions AG	18.15 Uhr	Ende der Veranstaltung und Bustransfer an die Oberseestrasse



Teilnahmegebühr

CHF 230.– pro Teilnehmer/in

Anmeldung und weitere Informationen

Anmeldung: ost.ch/iwk/klebstoff-forum

Anmeldeschluss: 18. Juni 2024

Abmeldung: kostenfrei bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Nach dieser Frist ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen.

Datenschutz

Wir weisen Sie darauf hin, dass während der Veranstaltung Bild- und Videoaufnahmen gemacht werden. Der Veranstalter kann diese für Marketingzwecke nutzen. Ihre Daten werden an der OST – Ostschweizer Fachhochschule gespeichert. Ihre Anmeldedaten (Name, Vorname und Firma) werden auf einer Besucherliste an die Teilnehmenden ausgehändigt.

Kontakt

OST – Ostschweizer Fachhochschule
IWK Institut für Werkstofftechnik und
Kunststoffverarbeitung
Eichwiesstrasse 18b
8645 Rapperswil-Jona, Switzerland

T +41 58 257 49 63

iwk@ost.ch, ost.ch/iwk

Über allfällige Anpassungen im Programm werden Sie rechtzeitig informiert.

